产品描述

Ancham AS4215一种双组份、高导热有机硅灌封胶产品；100%固含量弹性体，专为电子封装而设计；主要满足产品在使用时低应力、高热传导需求。提供了阻燃、绝缘、热传导、低模量、密封性能。可实现自动化生产，常温固化，加热可以加快其固化速度；低粘度，良好的流平性和渗透性；高电气绝缘性能，低应力应用，良好的耐温性能。

固化前材料性能

A组分	
外观	白色液体
粘度（25℃,cP）	6000±1000
B组分	
外观	红色液体
粘度（25℃,cP）	5500±1000
混合比例（重量/体积）	1：1
操作时间（25℃,min）	50
初固时间（25℃,h）	1-2
完全固化（25℃,h）	4-6
加热固化（80℃，min）	10-15

固化后材料性能

比重（g/cm³）：	2.5±0.1
导热率（W/m.k）：	1.7
硬度（Shore A）：	50±5
撕裂强度（N/mm）	1.0
拉伸强度（MPa）	0.5
断裂伸长率（%）	100
击穿电压（Kv/mm）：	≥7
体积电阻率（Ω.cm）：	10^{14}
介电常数（1M Hz）：	5.6
耐温范围（℃）：	-40～200
防火性能:	UL94 V-0

使用指南

把A、B两种组份按照1：1的比例充分混合后，尽让在50分钟内浇注入元器件内；在搅拌过程中可能会有少量气泡产生，一般会在浇注后自动消除；如果采用双组份灌胶设备浇注，或在手动搅拌后进行真空脱泡处理，可以有效避免气泡。

本品长期静止放置，会出现沉降现象，使用前需分别将A剂、B剂搅拌均匀。

建议使用带抽真空的双组分混胶机施胶。
本产品即可室温固化也可加温固化，不同温度条件下的固化时间如下：
在25℃初固1-2h
在25℃固化4-6h
在80℃固化10-20min

兼容性

某些材料、化学制剂、固化剂和增塑剂可以抑制本品的固化。应注意以下物质：

有机锡和含有机锡的硅橡胶；
硫、聚硫化合物或含硫物品；
胺、聚氨酯橡胶或含氨的物品；
亚磷或含亚磷的物品；
酸性物品（有机酸）；
助焊剂残留物；

若用胶前怀疑含有上述物质，建议先做样品试用验证后再批量生产。 必要时需做清洗处理。

贮存条件

本品为无毒非危险品，避免雨淋和曝晒，储存于阴凉干燥处，保质期6个月。
除标签上另有说明外，本产品理想贮存条件是在8 - 28°C温度范围内的阴凉干燥处。产品贮存温在8 - 18°C的条件将会更理想。为了避免污染，不要把倒出的胶倒回原包装。

包装规格

10KG/桶

注：本文中所含的各种数据仅供参考，并确信是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在用户的哪一种生产方法上，及采取哪一种措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，公司明确声明不担保因销售本产品或特定场合下使用该产品而出现的问题。本公司明确声明对任何间接或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任。本文中所论述的各种生产工艺或化学成分都不能被理解为这些专利可以被其他人随便使用和拥有，或被理解为得到了包括这些生产工艺和化学成分的专利许可证。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。